

基板製造仕様

番号	項目	摘要	単位	通常基板	備考
1	基板材料	FR-4 FR-5 など		ポリイミド、液晶ポリマー (LCP)	PET材も特定の仕様で対応可能
2	最大基板サイズ	W×D	mm	460×570	
3	原版サイズ	W×D(複数ある場合は、全て記入をお願いします)	mm	500×610	
4	層数	2,4,6,8,10,12(最大層数)		8層	理論上は28層までは可能
5	工法	貫通スルーホール	可/不可	可	
6		IVH	可/不可	可	
7		ビルドアップ	可/不可	不可	実績はあるが信頼性に不安
10	基板厚	最少～最大(層数で変更がある場合はそれも記入願います)	μ	12.5～50(片面及び両面の場合)	多層の場合は別途相談
11	板厚公差		-	規定無し	コネクタ勘合部はコネクタ資料に準ずる
12	銅箔厚	外層	μ	5,12,18,35,70,105	
13	銅箔厚	内層	μ	12,18,35,70	
14	導体幅		mm	フィルム:0.1、DI:0.075(銅はく厚による)	実績値は0.04(銅はく厚12μ)
15	導体間幅		mm	フィルム:0.1、DI:0.075(銅はく厚による)	実績値は0.04(銅はく厚12μ)
16	アニュアリング(annular ring(width))	外層	mm	フィルム:0.1、DI:0.075	
17	(ランド径とドリルビット径の差)	内層	mm	フィルム:0.15、DI:0.1	
18	小径Via仕様	外層ランド径	mm	フィルム:Φ0.35、DI:Φ0.3	
19		内層ランド径	mm	フィルム:Φ0.4、DI:Φ0.35	
20		ドリル径	mm	Φ0.15	レーザ加工によりΦ0.1も可能
21	最大スルーホール径		mm	Φ6.2	
22	穴径公差	ドリル径	mm	±0.05	
23		スルーホール穴径(銅めっき後)	mm	±0.05	
24		無電解金めっき	mm	±0.05	
25		電解金めっき	mm	±0.05	
26		水溶性プリフラックス	mm	±0.05	
27		はんだレベラー	mm	対応不可	
28	穴位置精度	穴-穴間	mm	±0.05	
29	アスペクト(板厚/ドリル径)			規定無し	
30		無電解金めっき	可/不可	可	ボンディング金めっきも可
31	表面処理	電解金めっき	可/不可	可	ボンディング金めっきも可
32		水溶性プリフラックス	可/不可	可	
33		はんだレベラー(共晶/Pbf)	共/F	対応不可	電解はんだめっきであれば可
34		エポキシ系樹脂	可/不可	対応不可	
35	Pad ON Via(Viaの穴埋め)	導電性樹脂	可/不可	対応不可	
36		レジスト	可/不可	カバーレイにて代用	
37	コネクタ部メッキ処理	基板にコネクタ端子を作成する場合	可/不可	可	
38	レジスト処理	カバーレイ 精度	mm	±0.2	±0.1まで対応可能
39		カバーレイ 最少幅(残りシロ)	mm	0.3	レーザであれば0.1まで可
40		フォトタイプ 精度	mm	フィルム:±0.1、DI:±0.05	
41		フォトタイプ 最少幅(残りシロ)	mm	フィルム:0.1、DI:0.05	
42		レジスト色	色	緑、褐色	硬質基板用であれば白、黒も可
43	外形加工精度			±0.1(ただしケーブルの長手方向は別途相談)	コネクタ勘合部は±0.05
44	Vカット仕様	位置精度	mm	対応不可	
45		残り板厚最少	mm	対応不可	
46	ミシン目加工	最小幅	mm	0.5	
47	検査方法	通電検査(インピーダンス検査除く)	可/不可	可	
48		インピーダンス検査	可/不可	可	
49		AOI光学検査	可/不可	可	
51	UL規格	UL094など、満たしている基準名		未取得	
52	環境対応	RoHS	可/不可	可	
54	ガーバーフォーマット指定	RS274X	可/不可	可	
55		RS274D	可/不可	可	
56		その他(指定名称を記入願います)		DXF.DWG	